

- ★自らの業務の位置づけを再認識できる！
- ★マネージメントに必要な半導体産業における包括的な見識を習得できる！

1名分料金で
2人目無料

半導体技術の全体像 【LIVE配信】【アーカイブ配信】

～材料・前工程・後工程・設計の全体技術に関して、基礎知識から最新動向を網羅～

セミナーURLはこちら→<https://www.rdsc.co.jp/seminar/250810>

- ◆日時：2025年08月20日（水）12:30～16:30
- ◆アーカイブ配信：21日（木）～9月4日（木）何度でも受講可能
- ◆受講料：1名につき49,500円（税込、資料付）

会員（案内）登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円（税込）から
・1名で申込の場合、**46,200円（税込）**へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円（2人目無料）**です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】

株式会社BML Solutions 代表取締役 蒲原 史朗 氏

【ご経歴】

1988年 (株)日立製作所中央研究所入社
2003～2010年 (株)ルネサステクノロジー 生産本部
2010～2021年 ルネサスエレクトロニクス(株) 生産本部、インダストリアルソリューション事業本部
2021年～ 株式会社BML Solutions 設立 代表取締役
IoT&AIのソリューション開発・販売・コンサルティング
1996～1997年 University of California at Berkeley, Industrial visiting fellow
2006～2010年 国家PJ 次世代半導体材料・プロセス基盤プロジェクト(MIRAI) 兼務
2010～2014年 国家PJ 低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト(LEAP)
2014～2018年 首都大学東京非常勤講師兼務

【講演の趣旨】 半導体技術は多岐に渡り、技術者は縦割業務に従事しているのが現状であり、且つ半導体技術全体を包括的に把握する教材もまれである。このセミナーは、そのような背景のもと、短時間に半導体技術全般を俯瞰でき、最新の技術動向も把握できるように構成されている。セミナーを受講することにより、半導体技術全般を理解し、自らの業務の位置づけの再認識や、半導体産業において包括的な見識のものとマネージメントができるエンジニアを育成することの一助としたい。セミナーは、半導体材料の特筆すべき特性、チップの製造技術(前工程)、設計技術、パッケージ技術(後工程)を広く網羅するものになっている。

【プログラム】

- 半導体とは
～電氣的スイッチ材料～
 - 半導体の材料的特性
 - PN接合
 - 半導体トランジスタ
- CMOS技術
 - CMOSとは
 - CMOS基本回路
- 前工程とチップ設計
 - CMOS製造プロセス
 - CMOSスタンダードセル
 - CMOS設計フロー
 - CMOSチップレイアウト例
 - CMOS技術の進歩
- 後工程(パッケージング)
 - 後工程フロー
 - 後工程要素プロセス
 - パッケージの種類と最近の技術動向

『半導体技術全体像』セミナー申込書 FAX:03-5857-4812 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒LIVE/アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送